

Bienvenue sur O-Leading

Nous sommes fabricant professionnel de PCB avec plus de dix ans d'expérience. Gamme de produits - PCB multicouche, double face, double face, PCB flexible et MCPCB.

TROUS DE PLAQUE EN CUIVRE MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES TROUS NE PEUVENT PAS ÊTRE BRANCHÉS

Paquet avec film à bulles transparent incolore, 25 PCS / sac, mettre le dessicant sur le flanc, mettre la carte indicatrice d'humidité sur la face supérieure

VEUILLEZ CLIQUER SUR CES INFORMATIONS POUR PLUS D'INFORMATIONS: [Moteur Module](#)
[Fabricant Chine](#)

Description du produit

Détails rapides

Lieu d'origine	Guang dong, Chine (continentale)	Marque	O-Leading
Matériau de base	FR-4, aluminium	Épaisseur De Cuivre	0.5 oz-5 oz
Finition de surface	immersion or, OSP, HASL sans plomb	Épaisseur du plateau	0.1-5mm
Min. Ligne 0.2mm Largeur	0.2mm	Min. Interligne	0.2mm
Couleur	bleu, rouge, vert, noir. jaune	prix	0,1 \$ à 10 \$
applicable à	led, téléphone portable, climatiseurs, machines à laver	Taille	0.01m3-10m3
personnage	Carte de contrôle industrielle	Min. Taille du trou	0.2mm0.2mm
certificats	ISO9001, UL, RoHS, SGS	MOQ	10pcs
Q / CTN	10PCS-100PCS	desigh type	exigence du client
poids	0,01 kg à 5 kg		

Emballage & Livraison

Détails de l' emballage:	16 années fabricant professionnel de panneau de carte PCB d'OEM
Détail de livraison:	7-12days

16 ans de fabrication professionnelle de panneau de carte PCB d'OEM

article	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon
Nombre de couches	32	42	38	44	42	48

Ligne min / espace (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min forage diamètre (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Ratio d'aspect de la PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Toute interconnexion de couche	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Remplissage de la plaque via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Min. épaisseur du noyau (exclure le cuivre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diamètre de la perceuse laser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via sur enterré trou / empilé via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Matériel	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Cuivre lourd, etc.					
PCB de condensateur intégré	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Processus de surface	HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent d'immersion, étain d'immersion, Or flash, Plaquage au doigt en or, Plaquage en or dur sélectif, Masque de soudure pelable, encre de carbone					



www.o-leading.com

[Assurer une assemblée de haute qualité de carte PCB, fabricant de carte de circuit imprimé chine](#)

Notre équipe





Certifications



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component



ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [online family of databases](#).
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED

E490354

Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

	Cond Width			SS/ DS/	Area Diam	Solder		Temp		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Class	DSR				
Typ	mm(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-	
Multi-layer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) min:1.25	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.03)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	
O-LEADING-205												
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

http://www.ul.com/onlinecertifications/UL60716RMS/ewg/zpmv2.e490354/wiring-printed-component/10



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SNI1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new online certification platform, which provides a secure and efficient way for clients to manage their certification needs. The platform offers a range of services, including the issuance of certificates, the management of certificates, and the provision of technical support. For more information, please visit [www.sgscertification.com](#).

Member of the SGS Group (SGL SA)

Emballage & Livraison

Détails de l' emballage	16 années fabricant professionnel de panneau de carte PCB d'OEM
détail de livraison	7-12days

(Fournisseur de GOLDEN FINGER BOARD)



FAQ

1. Comment O-Leading assure-t-il la qualité?

Notre niveau de qualité élevé est atteint avec ce qui suit.

1. Le processus est strictement contrôlé selon les normes ISO 9001: 2008.
2. Utilisation intensive de logiciels dans la gestion du processus de production
3. Équipements et outils de test de pointe. Par exemple. Sonde volante, inspection par rayons X, AOI (inspecteur optique automatisé) et ICT (test sur circuit).
4. Équipe d'assurance qualité dédiée avec un processus d'analyse de cas d'échec
5. Formation et éducation continues du personnel

2. Comment O-Leading maintient-il votre prix compétitif?

Au cours de la dernière décennie, les prix de nombreuses matières premières (cuivre, produits chimiques, par exemple) ont doublé, triplé ou quadruplé; La monnaie chinoise, le RMB, s'est apprécié de 31% par rapport au dollar américain; Et notre coût de la main-d'œuvre a également considérablement augmenté. Cependant, O-Leading a maintenu nos prix stables. Cela correspond entièrement à nos innovations en matière de réduction des coûts, d'évitement des gaspillages et d'amélioration de l'efficacité. Nos prix sont très compétitifs dans l'industrie au même niveau de qualité.

Nous croyons en un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Notre partenariat sera mutuellement bénéfique si nous pouvons vous fournir un avantage sur les coûts et la qualité.

3. Quels types de conseils d'administration O-Leading peut-il traiter?

Panneaux communs FR4, à haut TG et sans halogène, Rogers, Arlon, Telfon, panneaux à base d'aluminium / cuivre, PI, etc.

4. Quelles données sont nécessaires pour la production de PCB?

Il est préférable de fournir des données au format Gerber 274-X. De plus, Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP et Eagle peuvent également être traités.

5. Quel est le processus typique pour les circuits imprimés multicouches?

Découpe de matériau → Film sec interne → Gravure interne → AOI interne → Liaison multiple → Empilement de couches Appuyer sur → Perçage → PTH → Plaquage de panneaux → Film sec externe → Placage à motifs → Gravure externe → AOI externe → Masque de soudure → Marque de composant → Etat de surface → Routage → E / T → Inspection visuelle.